

HD

D-Sub connectors - Stamped and Formed Contacts



RIGHT ANGLE HIGH DENSITY CONNECTORS

MAIN CHARACTERISTICS

Specifications

- Connectors according to: MIL C24308

Materials and Platings	
Shells	Steel with nickel plating
Body	Glass filled thermoplastic, UL 94V-0
Contacts	Copper alloy, selective gold plating
Rear insert	Brass with nickel plating
Screwlock	Brass with nickel plating
Grounding clip	Copper alloy with tin plating

Electrical Data	
Current rating	5A
Voltage rating	600V AC/rms 50Hz
Withstanding voltage	1000V AC/rms 50HZ for one minute
Insulation resistance	5000MΩ
Contact resistance	10mΩ Max.

Climatic Data	
Operating temperature	-55°C to +125°C

Mechanical Data		
Mating and unmating force		
Unit: kg (lb)		
No. of Cts	Mate (max)	Unmate (min)
15	3.81 (8.42)	0.52 (1.14)
26	5.95 (13.16)	1.05 (2.32)
44	9.26 (20.46)	1.37 (3.02)
62	13.48 (29.78)	1.76 (3.88)
Standard plating thickness		
<ul style="list-style-type: none"> • gold flash • 0.4μm (15μ") gold • 0.76μm (30μ") gold 		

DESCRIPTION

Amphenol's high density D-Sub connectors complement Amphenol's extensive D-Sub connector line. This line offers many superior features, high performance level and low installation cost.

The decreased contact spacing accommodates greater signal density in comparison to conventional D-Sub connectors.

*Economical
right angle PCB*

APPLICATIONS

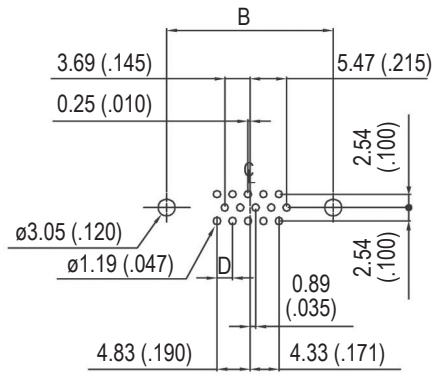
- Industrial
- Telecom
- Any industry standard I/O connections



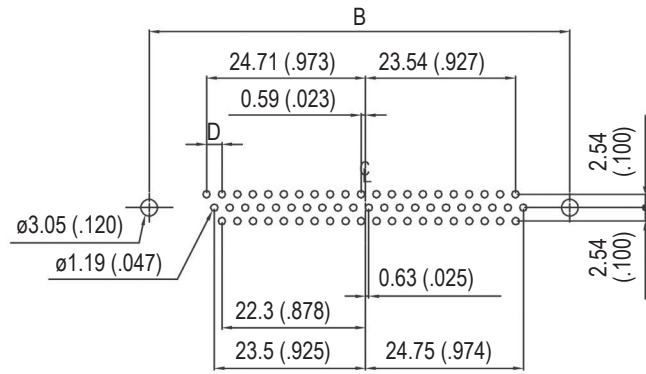
Amphenol

HD / E19

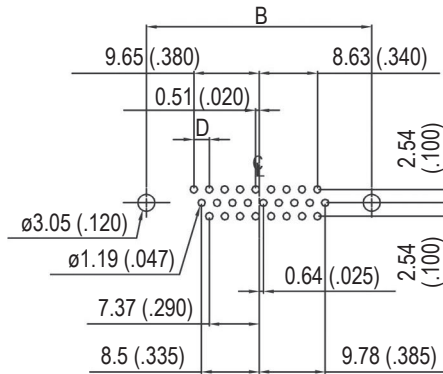
P.C.B. Layout



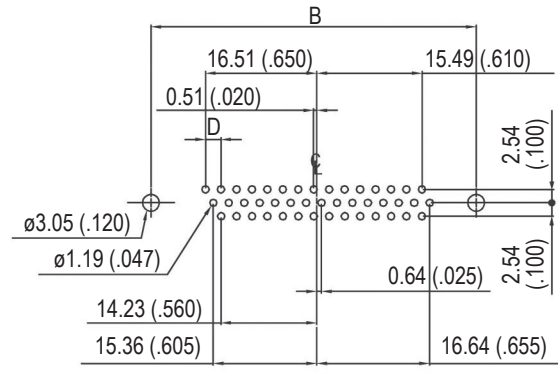
15 PIN



62 PIN

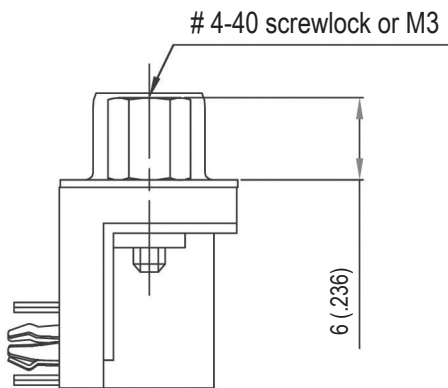


26 PIN

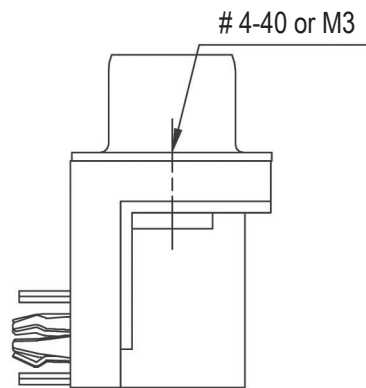


44 PIN

Panel mounting option



Front female screwlock
4F / 3F



Threaded rear insert
4R / 3R

Shell size dimensions



NB OF CONTACTS	DIMENSIONS mm (inch)			
	A	B	C	D
15	30.84 (1.214)	24.99 (.984)	16.26 (.640)	2.29 (.090)
26	39.24 (1.545)	33.32 (1.312)	24.56 (.967)	2.29 (.090)
44	53.04 (2.088)	47.04 (1.852)	38.30 (1.508)	2.29 (.090)
62	69.34 (2.730)	63.50 (2.500)	54.76 (2.156)	2.41 (.095)

How to order



For special request, please consult factory

Do not hesitate to contact us for further information

Amphenol

Amphenol IT & Communication Products

Block A3/A4, The 4th Industrial District of
Industrial Headquarters, Dong Keng Road
Gong Ming Town, Shen Zhen China
Fax: +86(0)755 2754 9955

Technical Support

Tel: +86(0)755 2717 7945
Info-dsub@amphenol.com.cn
<http://www.dsubconnector.com>



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.